

Fragenliste 2. EMV Test Tillich

1. Erkläre und beschreibe die wichtigsten Designregeln für den Leiterplattenentwurf?
2. Welche Maßnahmen sind erforderlich um Leitungsreflexionen am Print zu vermeiden?
3. Wie sieht ein vernünftiges Massekonzept am PCB aus und welche Bedeutung haben dabei Stützkondensatoren?
4. Welche Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Prints gibt es und welche Eigenschaften haben diese Leistungen?
5. Gib einen Überblick darüber, welche Arten von Verbindungskabeln zwischen Leiterplatten möglich sind. (Vor- / Nachteile)
6. Welche Probleme können bei schnellen Signalen und verhältnismäßig langen Leitungen auftreten und was kann man dagegen unternehmen?
7. Worauf beruht die Schutzwirkung von Metallgehäusen und was muss dabei beachtet werden?
8. In welcher Weise kann ein Gehäuse die „EMV-Performance“ eines elektrischen Gerätes beeinflussen.
9.
 - a. Berechne die Dämpfung (dB) der folgenden Filterschaltung für sehr hohe Frequenzen ($f \rightarrow \infty$)
 - b. Versuche die Übertragungsfunktion zu skizzieren

